



HoLR3637封体合金电阻系列

系列号	HoLR
修订日期	2022-05-20
版本号	Ho-A0

规格书 Specification

制造商: 深圳市毫欧电子有限公司

HoLR3637

适用: 本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoLR3637系列产品选型。

产品特点 Features:

电子束焊接合金电阻, 4-端子结构, 纯铜电极, 是电流检测应用的理想解决方案。

产品一致性好, 可靠性, 稳定性高, 耐脉冲能力强, 支持±0.5%的阻值公差。

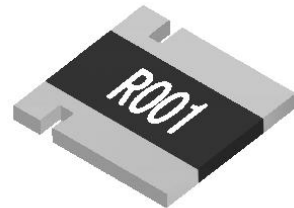
特殊焊接工艺, 全金属结构, 支持低阻(低至 0.0002R)耐高温树脂模压封装, 耐候性强。

极低的热电动势 (<1 uV/C)。

超低寄生电感 (0.5nH 到 3nH), 响应速度快, 可用于高频交流电流的检测。

通过 AEC-Q200 汽车级可靠性测试。

符合 RoHS 等环保要求。



产品名称 Product Name

封体合金电阻

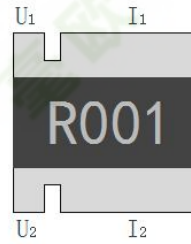
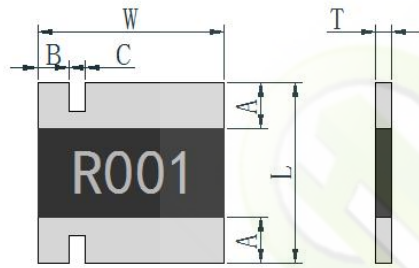
产品型号 Product number

Ho	LR	3637	5	R008	F	75ppm
制造商	产品系列	封装	额定功率(W)	阻值(mR)	精度(%)	温漂TCR
Ho 毫欧电子	LR 合金	3637	5	例: R001=1mR	F=±1	±150ppm
				0.2mR		
				0.3mR~1mR	±75ppm	
				2mR~10mR		



地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

产品尺寸 Product Size



注:

- U1和U2: 电压感应连接
- I1和I2: 电流连接

产品尺寸: mm

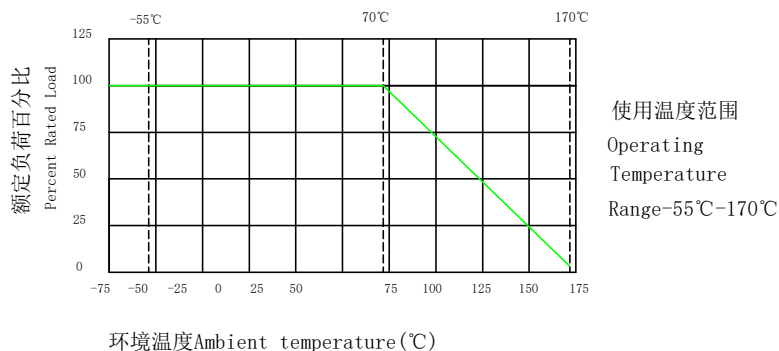
型号	阻值mR	L	W	T	B	C	A
HoLR3637	0.2mR	9.1±0.25	9.4±0.25	1.6±0.25	0.8±0.25	0.82±0.25	3.5±0.25
	0.3mR~1mR						3.2±0.25
	2mR~10mR						2.4±0.25

建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension


推荐焊盘及尺寸(单位mm):					
	系列号	阻值	a (mm)	b (mm)	c (mm)
	LR3637	0.2mΩ--1mΩ	9.91	4.27	1.88
		2mΩ--10mΩ	9.91	3.18	4.06

功率曲线 Power curve

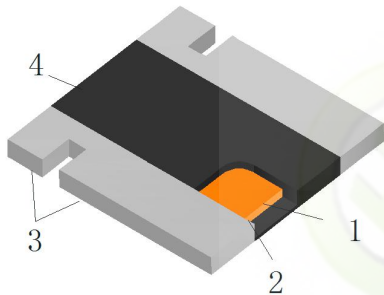
操作温度范围 -55 ~ +170 °C 电阻温度达到 70°C 时降功率示意图



地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

 毫欧电阻 毫欧制造	HoLR3637封体合金电阻系列	系列号	HoLR
		修订日期	2022-05-20
		版本号	Ho-A0

■ 产品结构 Product structure



1. 电阻材料：锰铜，卡玛或铁铬铝合金。
2. 电子束焊接结构。
3. 紫铜端子表面镀镍+锡。
4. 耐高温绝缘阻燃树脂。

■ 可靠性测试 Reliability Tests

Test Items	Reference standard	Condition of Test	Test Limits
Temperature Coefficient of Resistance	IEC60115-1-4.8 JIS-C5201-4.8	+25°C ~ +125°C	Refer 4.0
Load Life	IEC60115-1-4.25.1 JIS-C5201-4.25.1	1000hours at rated power, 70°C, 1.5hours "ON", 0.5hour "OFF"	< ±1%
Short Time Overload	IEC60115-1-4.13 JIS-C5201-4.13	2 X rated power for 5s	< ±1%
Moisture no Load	IEC60115-1- 4.24.2.1a) JIS-C5201- 4.24.2.1a)	85°C, 85%RH, 1000hrs	< ±1%
Temperature cycle	IEC60115-1-4.19 JIS-C5201-4.19	-55°C & +155°C, 100cycle, 15min per extreme condition	< ±1%
Resistance to Soldering Heat	IEC60115-1-4.18 JIS-C5201-4.18	260±5°C for 10±1 sec	< ±0.5%
Solderability	IEC60115-1-4.17 JIS-C5201-4.17	245±5°C, 2±0.5sec	At least 95% of surface area of electrode shall be covered with new solder
High Temperature Exposure	IEC60115-1- 4.23.2 JIS-C5201-4.23.2	155°C, 1000hrs	< ±1%
Low Temperature Storage	EC60115-1- 4.23.4 JIS-C5201-4.23.4	-55°C, 1000hrs	<±1%
Substrate Bending	IEC60115-1-4.33 JIS-C5201-4.33	Bending width 2mm	< ±0.5%
Insulation Resistance	IEC60115-1-4.6 JIS-C5201-4.6	100V DC for 1 minute	>100 MΩ

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼